文章编号: 1006-2467(2007) S-0032-04

# 基于 RF M EMS 开关的移相器设计

陈华 君<sup>a</sup>, 郭东 辉<sup>a, b</sup> (厦门大学 a. 物理系: b. 电子工程系, 厦门 361005)

**摘 要**: 传统电子移相器由于损耗问题难以向更高频率发展, 射频微机电系统(RF MEMS) 技术的 出现使其得以替代半导体开关来设计更高频率的移相器. 利用具有优异 RF 性能的串 联电阻式 RF MEMS 开关来进行开关线式移相器设计, 通过开关 切换不同的信 号延迟通路, 以实现从 0~180° 步进 22. 5°的 相移功能. 仿真结果表明, 该移相器在 5.8 GHz 时, 插入损耗在-0.3~-0.7 dB 变 化, 输入回损低于-20 dB, 相移功能正确.

关键词:移相器;开关线式移相器;相控阵天线;射频微机电系统 中图分类号:TN 432 文献标识码:A

# Switch-Line Phase Shifter with RE-MEMS Switch

CHEN Hua-jun<sup>a</sup>, GUO Dong-hui<sup>a,b</sup> (a. EDA Lab., Dept. of P ysics; b. Dept. of Electronic Eng., Xiamen Univ., Xiamen 361005, C ina)

Abstract: Due to t e losses of semiconductor switc , traditional electronic p ases ifter could ardly perform desirably at ig er frequency. RF MEMS tec nology demonstrates t at it could be used in p ase s ifter design as a substitute for traditional semiconductor switc . Since series resistor RF MEMS switc as excellent RF performance, it is used in t e design of switc-line p ases ifter. T is p ases ifter ar c ieves p ase s ift from 0° to 180° steps 22. 5° by using RF MEMS switc to switc between different delay-time lines. T e simulation results demonstrate t at t e insertion loss is from - 0.3 dB to - 0.7 dB, and t e return loss is lower t an - 20 dB. T e function of p ase s ift is correct.

Key words: p ase s ifter; switc-line p ase s ifter; p ase array antenna; radio frequency micro electro mec anical system (RF MEMS)

随着商业和军事系统日益向小型化、智能化和 灵活化系统的发展,对于低花费、重量轻和高性能天 线的设计需求也日益增加.其中,相控阵天线作为一 种智能化系统得到了很大的发展.而作为相控阵天 线关键组成部分的无源移相器,由于其相对简单,故 硬件结构成为一个重要的技术.传统电子移相器通 常使用 p-in 二极管、MESFETs 或者 pHEMT 作为 开关在不同电长度信号线之间进行切换,以得到所 需的相移.这些半导体开关的损耗问题抑制了传统 多位移相器向更高频率的发展<sup>[1]</sup>.

随着 RF M EMS 技术的出现, 在 毫米波频率, RF M EMS 开关成为低损耗移相器和其他控制电路

收稿日期: 2006-03-05

基金项目:福建省自然科学基金计划资助项目(A0410007);国家人事部留学人员创业基金项目联合资助

作者简介: 陈华君(1977), 男, 福建晋江人, 博士生, 主要从事射频/ 微波、微机电系统、集成电路方面的研究. 郭东辉(联系人), 男, 教授,

设计的一个关键的革新技术, RF MEMS 开关从直 流低频到 120 GHz 的微波毫米波均具有优秀的开 关性能<sup>[2-4]</sup>.其优势在于接近0的功耗和很低的插 入损耗,因此,近年来许多移相器设计中使用了低损 耗并联或者串联 MEMS 开关<sup>[5,6]</sup> 代替传统的半导 体开关,其损耗得到了大幅度的降低,这些 MEMS 移相器有的是基于传统开关线使用单端多掷开关<sup>[5]</sup> 设计,有的是使用 3 dB 耦合器的反射线设计[6],还 有的是用开关分布式 MEMS 传输线来改变波的相 速以产生一个相移,但是这种移相器的损耗在 Ka 频段仍然达到 - 5.1 dB. 在这些 MEMS 移相器设 计中,开关线式结构具有结构简单、计算方便、损耗 更低的优点. 然而. 这种结构由于延迟线的长度占用 了大量面积而相对较大,故在多位设计中,如何优化 结构设计使其进一步小型化,对于大孔径电子扫描 天线尤其重要.

为了进一步说明对于移相器设计的低功耗、小型化设计的要求,本文首先介绍了相控阵天线的基本工作原理,然后采用 RF MEMS 开关设计了一个从 0°~180°步进 22.5°的开关线移相器,最后通过仿 真分析了 RF MEMS 开关的损耗问题,并验证了移 相器的功能实现,得到了很好的 RF 性能结果.

## 1 相控阵天线

在相控阵天线中,对于每个天线单元的相位配 置控制是通过移相器来实现的. 这种电子扫描阵列 (ESAs)可以是有源的也可以是无源的.在有源相位 阵列中(见图1(a)),每个天线后面都直接连接发 射/接收(T/R)模块,再连接移相器,因此移相器损 耗不会对发射功率和噪声系数产生影响.但是,当需 要一个很大的天线扫描阵列时,如此多的 T/R 模块 使得整体系统体积大且非常昂贵,在无源相位阵列 中(见图1(b)),每个天线后面都直接连接移相器, 若干个移相器再连接一个 T/R 模块.这样虽然移相 器的损耗会直接影响系统发射功率及噪声系数,但 其优势在于使用更少数量的 T/R 模块和其他组成 部分,得到一个更简单、花费更低的系统.然而,这仅 在移相器具有十分低的损耗时才是可行的.因为T/ R 模块必须补偿移相器的损耗. 一个高损耗的移相 器意味着 T/R 模块必须具有更高的发射功率、更大 的尺寸和更昂贵的费用. 这样就难以实现使用无源 阵列来获得一个简单化的设计. RF MEMS 开关在 从直流低频到 120 GHz 范围内仍可保持低损耗和 低寄生效应的特性[25].利用这些开关可以消除在传 统移相器中存在的主要损耗成分,显著减少全部通

过移相器的 RF 损耗,使得单一功率放大器可以供应若干个天线单元,极大减少了相位阵列硬件的费用、重量和功率耗散问题.



# 2 移相器设计

RF M EM S 开关线移相器结构如图 2 所示. 该 结构由微带线和串联电阻式 RF MEM S 开关组成, 以高阻硅作为衬底材料. 微带线用来传播 RF 信号, 而串联电阻式 RF M EM S 开关则用来控制信号通 路的通/断,以实现不同信号通路之间的切换. 图 2 是相移从 0~ 180°步进 22.5°,对于从 0°~ 360°步进 22.5°的移相器,具有相同的结构原理,仅需多接一 段电长度为 180°的延迟线即可实现.





图 2 中,前后 2 个部分的结构设计原理是相同 的,都有 2 条通路.一个是参考通路,另一个则是根 据需要实现的相移制作得长一点的延迟通路.当参 考通路上的开关闭合,而延迟通路上的开关断开时, 信号通过参考通路传播,此时定义为 0° 相移状态. 当参考通路上的开关断开,而延迟通路上的开关闭 合时,信号通过延迟通路传播,比参考通路多传播了 所需要的电长度,此时就得到了延迟信号.为了得到 blis小步进相移,第一部分的延迟线通路又分为.4.条支 线,连同参考通路,总共5条通路,相邻两条通路之间的电长度相差 22.5°.因此,由第一部分的 RF MEMS开关可以控制选择从 0°~90°步进 22.5°,5 个不同的相移值.这样,利用重复使用同一小段信号 线可以有效地减小整个设计的尺寸,以进一步达到 小型化的目的.第二部分结构仅实现 0°和 90°相移. 两个部分结合就可以实现相移从 0°~180°步进 22.5°.图 3 所示分别为0°、22.5°、135°相移时的信号 通路示意图.



### 3 仿真分析

移相器的损耗主要来自于传输线损耗和 RF MEMS 开关的损耗.减少传输线长度可以相对有效 地降低传输线损耗,这主要是依靠减少参考线长度 来获得紧凑的结构设计实现的. RF MEMS 开关在 移相器中的损耗主要来自于偏置电极旁路作用以及 开关与传输线连接部分的阻抗匹配损耗.偏置电极 与开关桥之间存在寄生电容,特别是当开关桥被拉 下时电容值最大.这样就造成对 RF 信号的旁路作 用,增大信号损耗.

通过使用细导线来作为偏置网络连线,或在偏 置通路上加一个10 kΩ 偏置电阻的方法<sup>[7]</sup>可以减小 偏置电极泄漏的信号.而开关与传输线之间的阻抗 不匹配,会产生回波导致传输的能量损耗.通常,50 Ω 微带传输线在一定衬底上的宽度有个相应的值. 若该值与开关的信号通路宽度相差越小,则造成的 损耗也会越小;反之,则越大.在不匹配状态下,开关 的信号通路越长,损耗也会越大.因此,应尽可能使 得传输线宽度与开关的信号通路宽度接近,或者在 两者的接触位置采用锲行连接线也可相对减小损 耗.

RF M EM S 开关, 在本文设计的移相器中建立 的简化等效模型如图 4 所示. 图中: 微带信号传输线 的特性阻抗为 50 Ω, 开关的信号通路的特性阻抗为 75 Ω; 偏置电极在开关中间, 其寄生电容在拉下时 最大, 约为 5 pF; 再加一偏置电阻 10 k Ω, 以减小损 耗. 其仿真结果如图 5 所示. 由图可见, 在 5.8 GHz 时, 插入损耗为 – 0.044 dB. 随着频率的增加, 即开

#### 关的信号通路电长度增加,插入损耗将逐渐增大.



#### 图 4 传输线与开关连接的等效模型

Fig. 4 Equivalent model at t e conjunction of transmission line and switc





本文设计的 RF MEMS 移相器选择高阻硅( $\epsilon$  = 11.9)作为衬底材料,其结构(见图 2)由两部分组 成:第一部分结构的 8 段纵向延长线的长度都约为 1/32 波导波长,即 $L_1$ = 0.53 mm.第二部分结构的 纵向延长线长度约为 1/8 波导波长,即 $L_2$ = 2.12 mm.2 个部分的参考通路长度皆为 0.53 mm.微带 传输线的宽度取w= 0.13 mm,使得输入输出阻抗 达到 50  $\Omega$ . RF MEMS 开关尺寸为 0.1 mm × 0.05 mm.

通过控制 RF MEMS 开关来切换信号通路,可 以得到 9 种相移状态,图 6 所示为该移相器的 RF 性能的仿真结果.由图 6(a)可见,在5.8 GHz 时,移 相器的插入损耗  $S_{21}$  在-0.3 dB(0°相移时)~-0.7 dB(180°相移时)变化.在0°相移时,由于传输线最 短,并且信号通过的开关也最少,故其插入损耗  $S_{21}$ 最小,而其他状态则较大,但整体平均损耗仍然很 小,约为-0.5 dB.移相器的插入损耗随着频率的增 加而有所变大,在20 GHz 范围内的插入损耗  $S_{21}$ 都 小于-1.8 dB.由图 6(b)可见,在所有相移状态下, 其输入回波损耗  $S_{11}$ 都低于-20 dB.该移相器的相 移结果如图 7 所示.在5.8 GHz 时,仿真相移结果 与预期结果符合.

第 41 卷



图 6 插入损耗 S<sub>21</sub>和输入回损 S<sub>11</sub>

Fig. 6 Insertion loss  $(S_{21})$  and return loss  $(S_{11})$ 



4 结 语

随着未来通信技术向着毫米波甚至更高频段的 深入, RF MEMS以其优异的RF性能逐渐取代传 统半导体开关用于移相器设计中.本文采用串联电 阻式 RF MEMS 开关来设计移相器,实现从 0°~ 180°步进 22.5°的相移功能.该结构对于不同的相移 使用了共用部分延迟线,而非单相移单延迟线的结 构,因此可以减小整体面积.并且在 5.8 GHz 时其 输入回损小于-20 dB,插入损耗在-0.3~-0.7 dB 变化.该结构可以符合相控阵天线中单一功率放 大器供应若干个移相器及天线单元的需要.

#### 参考文献:

- [1] Campbell C F, Brown S A. A compact 5-bit p ases s ifter MMIC for K-band satellite communication systems [J]. IEEE Trans Microwave Theory Tech, 2000, 48: 2652-2656.
- [2] Rebeiz G M , Muldavin J B. RF MEMS switc es and switc circuits[J]. IEEE Microwave Magazine, 2001, 2(4):59-71.
- [3] Rizk J B, T an G L, Muldavin J B, et al. Hig-isolation W-band MEMS swite es [J]. IEEE Microwave and Wireless Components Lett, 2001, 11:10-12.
- [4] Goldsmit C L, Yao Z, Es elman S, et al. Performance of low loss RF M EM S capacitive switc es [J].
  IEEE Microwave Guided Wave Lett, 1998, 8: 269 271.
- [5] Pillans B, Es elman S, Malczewski A, et al. Kaband RF MEMS p ase s ifters[J]. IEEE Microwave and Guided Wave Lett, 1999, 9:520-522.
- [6] Malczewski A, Es elman S, Pillans B, et al. X-band RF M EM S p ase s ifters for p ased array applications [J]. IEEE Microwave and Guided Wave Lett, 1999, 9:517-519.
- [7] Tan G L, Mi ailovic R E, Hacker J B, et al. Low-loss 2- and 4-bit TTD M EMS p ases ifters based on SP4T switc es [J]. IEEE Trans Microwave Theory and Techniques, 2003, 51(1):297-304.